

# 智鼎電子股份有限公司

## 前置作業準備 Check list

客戶:

專案名稱:

預計打件日期:

### 一.工程資料:

項目	資料名稱	檢核內容	結果	說明
1	BOM	1. 生產版本是否正確? 2. 各欄位定義是否清楚? 3. 資料是否有漏列或被隱藏?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	Gerber	1. 檔案格式是否可用? 2. 所需的圖層是否完整? 3. 與實際 PCB 是否相符?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	座標檔	1. 檔案格式是否可用? 2. 是否為中心點座標? 3. 與 Gerber 版本是否相符?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	文字圖 極性圖 不上件圖	1. 列印出來文字字體是否清楚? 2. 是否需要鏡射翻轉? 3. 與 Gerber 版本是否相符? 4. 極性定義是否清楚?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	作業規範	1. 是否有提供規範及注意事項? 2. 所規範的事項是否清楚瞭解?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	實裝 Sample	1. 是否有提供樣品作為依據? 2. 與生產的 PCBA 是否一樣? 3. 是否有經過認可及掛卡?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	Dummy Board	1. 是否有提供 Dummy board? 2. 外觀及排版是否與實板一樣? 3. 是否有光學點及郵票孔?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### [注意]

1. 項次 1~4 項必須於打件前五個工作天提供,並於前三天完成確認。
2. 項次 5~7 項必須於打件前三個工作天提供。
3. Final BOM 必須於打件前一天確認不再更新,至打件前允許五項內小更動,超過則打件時間需往後延。
4. 以上可視產品複雜性及急迫性做調整。
5. 各項資料的用途及說明請參閱附件。

# 智鼎電子股份有限公司

## 前置作業準備 Check list

客戶:

專案名稱:

預計打件日期:

### 二.發料:

項目	檢核內容	結果	說明
1	發料單	1. 生產版本是否正確? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 料號欄是否與 BOM 一致? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 無料號時是否有編列項次? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. RLC 零件是否有充裕 Buffer? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 替代料是否有詳細說明? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. 是否有列出烘烤零件及條件? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	料況	1. Reel 包裝料帶的前端是否有 10 公分以上之空白? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. Tray 盤與零件是否適用? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. Reel 的膠膜是否有爆裂? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 標籤的數量與實際是否正確? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 標籤的料號品規是否清楚? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. Reel 材料是否為一段一段? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### [注意]

- 打件前四個工作天需領回百分之九十以上的材料,並於打件前一天全部補齊。
- 所謂充裕的 Buffer 可參考下列計算公式:

$$( \text{生產套數} \times \text{單位用量} \times \text{拋料率} ) + 10 \text{ 公分空白數} + \text{Buffer 數}$$

說明 : (1). 10 公分空白數 : 若料帶前端被剪平,爲了能上機台料架必須加上此數。  
新料捲前端已有空白則不需要。

(2) Buffer 數 : 由於試產的套數都不大,光是拋料率是不夠的.舉例 20 套來說  
 $20 \times 1 \times 3\% = 0.6 \text{ pcs}$  連一顆都不到,因此爲了試產順暢必須要有 Buffer , 通常 RLC 類:100pcs 以上,小型晶體類:50pcs 以上  
 其他視情況而定,總之 Buffer 準備愈充裕,試產時就愈順利。